



## 具有硅通孔结构的半导体器件

文献类型: 专利

**作者** 孙蓉; 张国平; 赵松芳

**发表日期** 2012-11-15

**专利国别** 中国

**专利号** CN201220604325.7

**专利类型** 实用新型

**权利人** 中国科学院深圳先进技术研究院

**公开日期** 2013-06-05

**授权日期** 2013-06-05

**源URL** [<http://ir.siat.ac.cn:8080/handle/172644/297>]

**专题** 深圳先进技术研究院\_先进院专利

**推荐引用方式** 孙蓉,张国平,赵松芳. 具有硅通孔结构的半导体器件 . CN201220604325.7. 2012-11-15.

**GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [深圳先进技术研究院](#)

浏览

12

下载

2

收藏

0

### 其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

